

中芯国际集成电路制造有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，于 2024 年 3 月 29 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 29 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。2024 年，公司聚焦主业经营、持续科技创新、提升治理效能，持续提升公司核心竞争力，并通过多渠道投资者交流、践行 ESG 理念等系列举措，向资本市场积极传递公司价值。

2025 年，公司将继续推进产能建设上台阶、绑定客户拓市场、降本增效优运营，在经营管理、研发创新、公司治理及投资者关系等方面采取积极措施，以进一步提高公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2025 年度行动方案主要举措如下：

一、聚焦集成电路代工主业，深耕服务全球客户

—— 稳步推进产能建设，公司季度收入节节攀升

公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者。基于国际化运营的理念，为全球客户服务，建立了辐射全球的服务基地与运营网络。

2024 年，主要产业进一步向国产链转移切换，为满足客户需求，加强规模经济效应，提升公司核心竞争力，公司加快产能扩充节奏，进一步提升平台完备性，客户新产品快速验证并上量，四个季度收入

节节攀升，全年销售收入为人民币 578 亿元，同比增长 28%，创历史新高；毛利率 19%，产能利用率 85.6%。2024 末，公司折合 8 英寸标准逻辑月产能达 94.8 万片，出货总量超过 800 万片。实现年初收入增长、产能推进、产能利用率提升和出货量提高的目标。

根据全球各纯晶圆代工企业最新公布的 2024 年销售额情况，中芯国际位居全球第二，在中国大陆企业中排名第一。

2025 年，外部环境带来一定的不确定性，同业竞争也愈演愈烈。面对挑战与机遇，公司将持续践行“做强做优做大中芯国际”的初心使命，继续推进（1）产能建设上台阶：持续高投入，推动公司收入规模成长；（2）绑定客户拓市场：加强供应链安全性、可靠性、韧性的管理，努力把握日益增长的在地制造需求；（3）降本增效优运营：以持续盈利为目标，通过提高产能利用率来对抗折旧。在外部环境无重大变化的前提下，公司预计 2025 年销售收入增幅高于可比同业的平均值，资本开支与上一年相比大致持平。

二、持续研发创新投入，促进提升新质生产力

—— 努力提升工艺平台，加速部署客户产品

公司多年来专注于集成电路工艺技术的研发，成功开发了 8 英寸和 12 英寸多种技术节点，应用于不同工艺技术平台，具备逻辑电路、电源/模拟、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、非易失性存储、混合信号/射频、图像传感器等多个技术平台的量产能力。可为客户提供智能手机、物联网、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车等不同领域的晶圆代工及配套服务。

2024 年，公司研发投入合计为 54.5 亿元人民币，同比增长 9%，占营业收入的比例为 9.4%。公司快速在多个技术平台推动工艺迭代

和产品性能升级，以技术创新为驱动力，始终坚持自主研发的道路并巩固自主化核心知识产权。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利共 13,964 件，其中发明专利 12,112 件。此外，公司还拥有集成电路布图设计权 94 件。

在模拟器件领域，公司持续拓展高电压、大电流、高性能、高可靠性的 8 英寸和 12 英寸工艺平台，快速导入各类型的消费电子、工业工控、汽车电子及新能源领域的终端应用。

在高压显示驱动领域，公司持续推动超低功耗及性能更好的 28 纳米高压显示驱动技术进入量产及终端应用，产能供不应求。

在图像传感器及图像信号处理器领域，公司提供更高像素、小单元、高密度的图像传感器产品，快速推出性能更好、超低功耗的图像信号处理器解决方案。

在功率器件领域，公司紧密对接客户需求，对标业界领先工艺，新推出了众多的功率分立器件平台，已实现量产并贡献收入，主要应用于手机、工业工控、新能源等领域。

在汽车电子领域，公司持续推出高性能、高质量、高可靠性的汽车电子技术及服务来满足芯片客户及汽车品牌方的需求，在高电压、大电流、高可靠性 BCD 及模拟平台、超低功耗逻辑平台、高性能微控制器平台、车规级显示驱动平台、高可靠性存储器平台等都已实现车规级认证、量产和终端应用。

2025 年，公司将继续打造技术平台的完备性，在各细分领域推出快速的技术迭代，为客户提供多元化平台和迁移技术，推进各平台从消费到工业、工业到汽车的认证，更有效地调动内外资源，提升对客户的服务力度、对问题的响应速度，快速提升产品的成熟度，保持各平台的领先优势、先发优势。在市场回暖但同时又面临激烈竞争的环

境下，通过打造领先技术来提升核心竞争力、绑定客户，通过增加新产品来对抗价格压力，以保持住公司在各个领域的市场份额和竞争优势。

三、不断提升公司治理水平，提高上市公司质量

——优化公司治理体系，助力关键少数合规履职

公司是一家设立于开曼群岛并在香港联交所及上交所科创板两地上市的红筹企业，现行的公司治理制度主要系基于公司注册地和境外上市的相关法律法规及规则制定。公司一直高度重视公司治理水平的提升和完善，不断强化在内控制度、规范运作等方面的合规管理。

2024 年，公司及时分析资本市场新规对公司治理及信息披露的影响，制定了 2 项制度并修订了 5 项制度，进一步优化公司治理制度及工作流程；汇编 A 股和港股资本市场新规，帮助董事及时了解监管趋势和政策变化，安排新董事培训及董高参加上市公司协会组织的培训班，提升董高履职水平；修订完善《子公司董监高委派管理办法》，并组织委派董监高进行履职培训，提升子公司治理水平；安排外部顾问为相关业务部门开展信息披露及新规培训，提升公司“关键少数”及全员的合规意识，切实推动公司高质量发展。

2025 年，公司将继续密切关注两地资本市场监管政策变化，定期向董高传递市场新规与监管案例；严格按照适用法律法规和监管要求，不断加强规范治理体系，完善内部控制与风险管理机制，提升公司治理水平和规范运作能力。同时借助监管部门、上市公司协会的培训课程，强化主要股东、董高等“关键少数”的合规意识，明确其在信息披露等方面职责，提升履职技能，推动公司合规稳健发展。

四、加强投资者双向沟通，构建多种沟通渠道

—— 推行公司市值管理制度，加强长期投资者沟通

2024 年，公司召开了四次业绩说明会、一次股东大会，管理层与资本市场清晰沟通了公司的经营管理状况、财务状况、产品技术、产能建设等事项信息，并且主动披露投资者关心的市场和公司相关信息，充分保护投资者合法权益，稳定和提升资本市场信心。

此外，公司通过公告、股东大会、上证 e 互动、投资者热线和邮箱、公司官网、企业微信公众号、路演、反路演、调研、券商大会、宣传资料、媒体采访等多渠道与投资者进行互动，并收集投资者意见和反馈，形成报告汇报管理层。同时公司优化了《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》，提升了制度体系的完备性，夯实了资本市场高质量发展基础，也响应了为股东公平公开服务的要求。

2025 年，公司将推进执行《市值管理制度》，及时监控公司相应指标变化并明确跟进措施；召开不少于三次业绩说明会，公司管理层保持与全球投资者沟通交流。此外，公司亦将继续通过以上提及的诸多渠道和平台，加强与投资者互动、回应市场关切，确保投资者能及时获得公司动态；公司将加强长期投资者的关系维护，使其更好地理解公司长期发展方向，加深对公司价值的理解，从而建立良好稳固的长期投资者关系。

五、贯彻落实“ESG”理念，实现公司可持续发展

—— 推行节能减排与绿色生产，积极践行社会责任

2024 年，在 ESG 管理体系的支撑下，公司在环境保护、社会贡献与公司治理方面均取得了显著成效。公司致力于节能减排与绿色生产，通过引进高效节能技术、优化生产流程、提升设备能效等措施，大幅

降低了能源消耗与温室气体排放。公司全年购买绿电 61,283 兆瓦时，完成年度碳交易市场碳履约工作，为实现国家的双碳目标贡献力量。公司积极履行社会责任，持续开展“芯肝宝贝计划”等公益项目，累计捐款近 5,000 万元，帮助 943 名肝病患儿重获健康；公司员工参与公益活动时数约 24,630 小时。公司自 2013 年起蝉联香港《镜报》“杰出企业社会责任奖”，2024 年入选央视“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单和“长三角 ESG 上市公司先锋 50”榜单等荣誉。

2025 年，公司将继续深化 ESG 实践，设定优化目标。公司将持续加大在绿色技术研发与应用上的投入，推动生产工艺的低碳化转型；同时，进一步强化企业社会责任的履行，提升企业透明度与公信力。通过不断探索与实践，公司将为实现经济效益、社会效益与环境效益的和谐统一贡献力量，携手利益相关方共绘可持续发展的宏伟蓝图。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日